

常州聚和新材料股份有限公司

关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“聚和”）于2026年3月31日披露了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司2026年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2026年上半年的主要工作成果报告如下：

一、稳定公司主营业务，拓展第二增长曲线

公司是一家位于中国的由研发驱动的先进材料企业。自 2015 年成立以来，公司持续加大研发投入，深化在先进材料领域（尤其是光伏导电浆料）的专业能力，公司的技术能力涵盖无机与有机材料的合成、配方设计、制造工艺、分析以及应用开发，并形成多元化的产品布局。同时，公司构建了稳定而高效的运营管理体系，以支持业务的持续发展及可持续增长。公司积极响应国家半导体自主可控的战略目标，通过境外收购及自主组建团队等方式切入半导体材料领域；截至报告期末，公司已完成对 SKE 空白掩模版业务的收购。

1、光伏导电浆料及先进电子材料业务

公司核心业务是开发及制造适用于不同光伏电池结构的完善光伏导电浆料产品组合。经过多年技术沉淀，公司已构筑起品类丰富、迭代迅速的金属化解决方案，能够满足市场主流高效光伏电池技术路线对导电浆料产品的需求，包括 TOPCon 正、背面主副栅成套银浆，HJT 电池用主、细栅银浆，X-BC 电池导电银浆，能与 P 型及 N 型-Poly 层形成良好接触的导电浆料、钙钛矿叠层超低温导电浆料等；随着光伏产业从 P 型 PERC 转向 TOPCon、HJT 及 X-BC 等高效 N 型技术，光伏导电浆料迎来结构性增长契机，市场需求强劲。同时，技术与工艺创新对浆料的高精度及定制化提出了更高要求，驱动厂商持续优化配方及生产工

艺，以确保严苛印刷条件下产品的导电性、稳定性与可靠性，进而推动行业向更高技术壁垒与更高附加值方向演进。

公司前瞻性布局少银化、无银化技术趋势，为客户提供全套贱金属体系浆料（银镍浆、银包铜浆、纯铜浆）、低固含导电浆料，新一代超窄线宽印刷浆料，有助于光伏行业及电池客户进一步降本，进一步巩固公司光伏导电浆料全球领导者地位。2026 年上半年，公司光伏导电浆料销量达 636 吨，已位列全球前列，成为行业领导者。

立足于光伏导电浆料领域的技术积淀，公司积极布局通信器件及电子元器件等浆料应用领域，并将业务延伸至金浆、钎氧化物浆料等高可靠性贵金属材料。公司旗下子公司匠聚、聚鑫耀依托电子浆料平台化技术，突破传统单一配方局限，通过纳米材料合成、多相界面调控和表面超分散等核心技术，开发出适配片式电阻、电容、电感等微型化、高频化元器件的专用浆料，显著提升器件导电效率与可靠性。在汽车电子领域，其浆料产品通过车规级认证，满足新能源汽车对高耐温、抗振动、长寿命的严苛需求。向多功能复合浆料延伸，并加速开发面向第三代半导体封装、柔性印刷电子的前沿材料，抢占技术制高点。横向拓展至 6G 通信器件、基础电子元器件等核心领域，深度参与国产替代；纵向切入新能源汽车三电系统，覆盖电池电极、传感器、车载电路等场景，与“双碳”目标形成强协同。突破传统材料供应商角色，形成提供“材料定制开发-器件联合设计-产线工艺匹配优化”的金属化解决方案的能力。凭借国产替代优势，公司深度融入头部客户供应链，助力中国电子材料产业实现本土化、安全与韧性发展。

在导电浆料的制备过程中，除了对原材料品质、选型要求较高以外，浆料的配料方案、制作工艺、量产稳定性需经过长期的研发攻关、持续优化，以确定适用于不同下游产品最优配方，从而达到预期的导电和应用效果。银粉是银基导电浆料的重要原材料，其性能直接影响产品表现。中国高端电子级银粉的供应历来依赖日本进口，给供应链稳定性带来挑战。公司战略布局上游粉体环节，未来将进一步强化浆料产品综合竞争力，同时降低生产成本，保障盈利能力。2023 年，公司收购了江苏聚有银，并启动了千吨规模电子级银粉产业化项目。公司旗下德力聚已拥有中国光伏导电浆料企业中最大的银粉产能。银粉自主研发与供应体系的建立，不仅支持产品定制，还提升原材料供应的稳定性，并保护公司技术竞争

力。

2、空白掩膜版业务

公司通过收购 SKE 的空白掩膜版业务，进入 DUV-ArF 及 DUV-KrF 光刻级空白掩膜版业务领域。

在芯片制造流程中，光刻作为晶圆制造的核心工艺环节，其价值量占比达到约 35%，同时其精度直接决定了最终芯片产品的性能与良率。而光掩膜版，作为光刻工艺的蓝图和图形转移的基准，在半导体材料成本中占比约 13%，是仅次于硅片和电子特气的第三大半导体材料。

在光掩膜版的制造流程中，空白掩膜版是产业链中价值量最集中、技术壁垒最高的上游基石。空白掩膜版的关键物理性能，如基板的亚纳米级平整度、功能膜层的光学均匀性及表面缺陷密度，从源头上决定了光掩膜版的图形刻写精度，进而直接制约着下游晶圆制造的良率天花板。从物理构成看，其系由经过精密抛光的高纯度基板（如合成石英或苏打玻璃）与纳米级功能薄膜层（含遮光膜及光阻层）复合而成。在光刻过程中，空白掩膜版会通过曝光、显影、刻蚀等工艺被加工成带有特定图案的光掩膜版，再将这些图形转移到基板上。作为光掩膜版的母材，空白掩膜版的平整度、膜层均匀性及缺陷密度等关键指标，直接决定了下游光刻图形转移的精度，进而对半导体芯片、平板显示面板等终端产品的制程良率与性能产生决定性影响。

空白掩膜版是半导体制造的核心材料，能够实现量产的公司较少。随着国内晶圆产能扩张、先进制程需求增加以及国家对关键半导体材料的战略扶持，空白掩膜版国产替代趋势确定。公司收购的空白掩膜版资产覆盖 14 纳米至 90 纳米制程。目前，空白掩膜版产品已通过 SK 海力士、TMC、迪思微、中微掩模等国内外半导体客户的量产验证，并实现量产销售，同时，国内部分客户已开展产品测试及送样。公司计划在上海建立生产设施，进行本土化产能扩张。

截至目前，公司半导体战略发布暨上海总部共建启动仪式已正式举行，全面提升半导体材料整体战略落地进程，夯实公司第二增长曲线。

二、持续加大研发投入，提前储备无银化、少银化新技术

报告期内，公司研发投入达到 5.70 亿元，占营业收入比例为 5.37%。公司持续保持对核心技术研发的投入，并致力于技术创新和产品升级，以提升其市场竞

争力和可持续发展能力。公司凭借“材料-工艺-设备”全栈自研体系，在光伏导电浆料领域构建了覆盖 TOPCon、HJT、X-BC 及钙钛矿叠层电池的全场景技术矩阵，实现多项金属化技术里程碑突破。

金属化环节在光伏电池成本中的占比较高，倒逼光伏行业加速技术迭代与供应链优化，以应对白银价格带来的刚性成本挑战。特别是当前光伏产业正在经历周期调整，阶段性供需错配导致各环节盈利承压，行业产能加速出清，在此背景下，少银化及无银化等金属化解决方案对光伏行业降本增效的影响将愈发凸显。公司以技术研发驱动产业升级为使命，致力于为光伏行业提供高质量的金属化解决方案。公司围绕新一代网版及印刷技术方向，高频、高效对接客户定制化浆料需求，同时提前储备少银化、无银化产品，例如推出“超细线印刷+低固含+无主栅”技术、银镍浆方案、银包铜浆方案、“种子层+铜浆”方案等，其中铜浆方案实现突破攻克铜高温氧化抑制难题，致力于推动光伏行业“减银-替银-无银”技术演进历程，为光伏行业的降本增效贡献力量。

三、不断提升公司治理水平，完善治理体系

2026 年上半年，公司密切关注法律法规和监管政策变化，高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，不断提升公司三会运作效率、重视“关键少数”履职能力建设、完善公司内部制度、推动公司整体治理水平的提升。

2026 年上半年，公司严格规范三会治理运作，累计召开股东会 2 次、董事会 3 次、专门委员会会议 4 次，有效落实董事会及各专门委员会的决策、审议与监督职能，持续提升公司法人治理规范化水平。

报告期内，公司持续跟进国家法律法规及资本市场监管政策的更新动态，以提升整体运营效率为核心抓手，持续强化新增、修订及重点管理制度的宣贯培训、落地执行与全过程监督，结合制度落地执行成效持续优化、搭建系统化、规范化的内部管理体系。

依据最新法律法规及监管规范性文件，同时结合港股合规管理要求及公司实际经营治理需要，公司积极开展制度梳理与体系优化工作。报告期内，公司修订完善了《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《股东会网络投票实施细则》《募集资金管理办法》等核心管理制度；同步新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《全面风险管理制度》《ESG 管理制度》等多项内控制度，进一步

补齐制度体系短板，适配境内外上市合规标准。

与此同时，公司持续健全风险预警与应急应对机制，常态化开展内部审计与风险评估工作，全面梳理迭代原有管理制度体系。重点优化内控制度层级架构，打通制度条款与信息化系统的流程衔接匹配，构建严谨、闭环、高效的制度化、流程化运营支撑体系。公司持续深化全面风险管理体系建设，明确各部门岗位职责、工作权限及管控要求，全方位筑牢合规经营防线，保障公司持续、稳健、规范运营。

2026 年下半年，公司将严格遵循最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及监管机构各项要求，持续推进内部管理制度迭代完善，进一步搭建更为健全、系统化、规范化的内部控制体系。公司将持续优化法人治理结构，持续提升合规规范运作水平，主动对标、积极响应独立董事制度改革相关政策精神，严格落实各项改革落地要求。同时，持续深化公司治理能力建设，重点强化控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的合规履职意识与责任担当，全方位夯实公司治理根基，助力企业实现持续健康高质量发展。

2026 年上半年，为适配公司港股 IPO 战略布局及境内外合规治理要求，公司完成 2 名独立董事换届更换工作，并组织新任独立董事开展专项任职培训，助力其快速熟悉公司经营情况、治理规则及两地监管合规要求，保障独立董事规范、高效履职。

报告期内，公司充分保障独立董事独立履职权利，积极发挥独立董事在规范公司治理、科学决策、风险防控中的监督与咨询作用，持续为独立董事履职提供全面保障与便利条件。公司多次组织就公司日常经营管理、业务发展、募投项目建设进展、未来战略规划等核心事项开展充分沟通与专项汇报，广泛听取独立董事专业意见，有效提升公司决策的科学性、规范性与严谨性。

后续公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，公司将继续督促董事和高级管理人员按时完成证监会、上交所要求学习的培训课程，邀请公司律师、审计机构对上市公司相关人员进行合规知识培训，确保董事、高级管理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

四、布局半导体材料赛道，扎根国产替代进程

在 AI 高性能计算、云计算等需求驱动下，全球半导体制造端扩产计划加速，将持续带动上游电子材料需求扩容。与此同时，在外部贸易壁垒日益增强与供应链安全考量下，半导体材料国产化已成为国家战略方向，关键电子材料长期依赖进口的格局正逐步改变，国产材料替代空间广阔。

公司紧抓半导体材料国产化的行业机遇，通过内生发展及外延并购结合的方式，切入半导体材料赛道。2026 年 3 月 31 日，公司成功收购了韩国 SKE 旗下空白掩模版事业部，补齐公司空白掩模版领域的技术、人员、制造能力，产品可覆盖主流 DUV 光刻工艺，已通过 SK 海力士、TMC、迪思微、中微掩模等国内外半导体客户的量产验证，并实现量产销售，同时，国内部分客户已开展产品测试及送样。此外，公司成立上海聚芯光新材料有限公司，聚焦光刻胶产品，核心研发团队已搭建完成。展望未来，公司致力于推进半导体材料产业国产化进程，将通过加大核心技术攻关、引进专业人才、强化研发体系建设、深化下游客户验证合作等举措，持续提升半导体材料业务的核心竞争力。

五、共享发展成果，注重投资者回报

报告期内，公司积极统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

公司本着重视对投资者的合理投资回报的原则，同时兼顾公司资金及发展需求的原则建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和稳定。2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.32 元(含税)，合计派发现金红利 1.00 亿元。2026 年 6 月 18 日实施了 2025 年利润分配方案，公司总股本 242,033,643 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份 10,550,334 股后的股本 231,483,309 股，合计派发现金红利 1.00 亿元（含税）。

公司自上市以来已累计派发现金红利 4.4 亿元，用行动实质回报投资者，全体股东共享公司发展红利。

六、提升信披质量，履行社会责任

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，

真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

2026 年上半年，公司持续深耕投资者关系管理工作，坚持以投资者需求为导向，不断健全资本市场沟通机制、提升信息披露质量与透明度。报告期内，公司常态化开展投资者沟通交流工作，累计召开 3 场专项业绩说明会，分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 28 日召开 2025 年度业绩说明会、2025 年度现金分红说明会及 2026 年一季度业绩说明会，并积极参与各类资本市场投资者交流会，主动向广大投资者全面介绍公司经营现状、业务布局及未来发展规划，高效回应市场关切。

信息披露方面，公司严格恪守合规、真实、准确、完整、及时的披露原则，持续优化信息披露工作体系，进一步提升信息披露的针对性、有效性与透明度。在定期报告、临时公告披露后，公司创新披露形式，通过业绩说明会、图文解读简报等可视化方式，对公告内容进行通俗化、立体化解读，帮助投资者直观、清晰地理解公司经营成果、财务状况、项目进展及发展战略，有效提升信息传递效率与可理解性。同时，公司积极践行可持续发展理念，主动履行社会责任，报告期内顺利披露 2025 年度 ESG 报告，系统展示公司在环境保护、社会责任、公司治理等维度的建设成果与实践举措，全面响应境内外资本市场 ESG 披露监管趋势与投资评价要求，持续提升公司规范化、高质量发展形象。

沟通渠道建设方面，公司构建了全方位、多层次、常态化的投资者沟通体系。通过设立专用投资者热线电话、投资者邮箱，依托上交所“e 互动”平台、线上线下业绩说明会、投资者现场调研、电话沟通、反向路演等多种形式，与投资者保持常态化、充分化的交流互动，持续夯实公司与资本市场之间长期稳定、互信透明的良性沟通关系。

为稳步推进公司港股上市相关战略布局，报告期内公司有序开展全球资本市场路演工作，先后在北京、上海、香港、新加坡、瑞士等多地组织专项路演活动，面向海内外机构投资者系统推介公司核心业务、竞争优势、战略规划与长期投资价值，充分对接国际资本市场，拓宽境外投资者沟通渠道，有效提升公司在海内外资本市场的品牌影响力与认知度，为公司境内外一体化资本市场布局奠定良好基础。

未来,公司将持续常态化开展业绩说明会、投资者交流等资本市场沟通工作,结合自身经营发展实际,持续精进信息披露工作,进一步提升披露质量与沟通效能。公司将持续深耕投资者关系管理工作,主动传递企业核心价值、稳定市场预期、树立资本市场信心。在持续向资本市场充分输出公司经营成果与发展战略、加深投资者认知与认可的同时,高效归集、梳理投资者关注重点与市场观点,及时反馈至公司管理层,精准响应市场变化与投资者合理诉求,实现公司与资本市场的良性双向互动。

七、其他事宜

公司将持续落地并动态评估“提质增效重回报”行动方案,扎实推进各项提质增效举措落地见效。公司始终坚守上市公司责任与担当,依托稳健的经营业绩、规范的治理体系持续回馈广大投资者的信任,全力维护公司股价长期稳定、健康发展。

经营发展层面,公司坚持主业深耕与第二曲线培育双轮驱动发展战略。一方面持续聚焦核心主业,不断优化经营管理模式,精进经营质量、核心竞争力与持续盈利能力,稳步推进全球化战略布局,进一步巩固并夯实公司行业龙头地位;另一方面,公司将坚定不移落地半导体材料战略布局,依托上海总部平台优势与产业集群资源,持续加速半导体高端材料研发攻关与产业化落地进程,持续完善半导体业务研产体系与人才梯队建设,稳步做大做强半导体新材料业务,持续拓宽公司成长边界、优化整体业务结构,打造公司长期高质量发展的核心增长引擎。

治理层面,公司持续迭代完善内部管理制度体系,搭建合规、高效、精细化的法人治理与内控管理体系,全面提升公司整体运营管理质效。公司将坚定不移落地“提质增效重回报”各项举措,以稳健主业业绩叠加半导体新业务成长动能、规范高效的公司治理持续回馈市场与广大投资者,积极助力稳定资本市场预期、提振市场信心,推动公司实现长期稳健、可持续的高质量发展。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日